

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-118

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠伦晶体”）于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、贷款及担保情况概述

根据公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金情况，为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，惠伦晶体（重庆）科技有限公司拟向中国银行重庆綦江支行申请人民币 5,200 万元的贷款，授信期限不超过 84 个月，以惠伦晶体（重庆）科技有限公司所有的渝（2020）万盛区不动产权第 000773039 号地块提供抵押担保，由公司提供连带责任担保，专用于高基频超小型频率元器件项目建设。

公司授权董事长或其授权人代表公司签署上述贷款额度内与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、保证、融资等法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以循环使用。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：惠伦晶体（重庆）科技有限公司
- 2、注册资本：9000 万元人民币
- 3、法定代表人：韩巧云
- 4、公司住所：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园
- 5、成立日期：2020 年 6 月 2 日

6、经营范围：电子专用材料研发，物联网技术研发，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，光电子器件制造，其他电子器件制造，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：惠伦晶体（重庆）科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、一年及一期主要财务数据：惠伦晶体（重庆）科技有限公司于 2020 年 6 月 2 日成立，截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 126,108,735.26 元，负债总额 54,158,139.00 元，净资产 71,950,596.26 元；2020 年 1-9 月，营业收入 0.00 元，净利润-49,403.74 元。

三、担保的主要内容

为满足惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金需要，保证高基频超小型频率元器件项目建设顺利实施，公司为惠伦晶体（重庆）科技有限公司向中国银行重庆綦江支行申请人民币 5,200 万元的贷款提供连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。具体授信额度及担保内容以公司及惠伦晶体（重庆）科技有限公司和银行实际签署的合同为准。

四、审批决策程序

公司与中国银行不存在关联关系，上述贷款及担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司向银行贷款专用于高基频超小型频率元器件项目建设，公司为全资子公司提供担保，有利于满足公司经营需求，抢占 5G、物联网

市场先机，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对全资子公司拥有控制权，能够有效控制和防范风险。

六、独立董事意见

独立董事认为：惠伦晶体（重庆）科技有限公司为公司的全资子公司，公司对其具有实际控制权，本次担保有利于满足其实际资金的需要，符合公司经营发展的需要。同时，本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》及《广东惠伦晶体科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关法规及制度要求，担保风险可控，未对公司及全体股东产生不良影响。独立董事一致同意本次全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 6200 万元（含本次担保），占 2019 年末公司经审计净资产的 11.85%。公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日